

ダイボンディングフィルムの機能と設計

稲田 禎一*

Function and Design of Die-Bonding Film for Semiconductor Packages

Teiichi INADA*

* 日立化成株式会社筑波総合研究所 (〒 300-4247 茨城県つくば市和台 48)

*Hitachi Chemical Co., Ltd., Tsukuba Research Laboratory (48 Wadai, Tsukuba-shi, Ibaraki 300-4247)